

# 高周波対応液晶ポリマー(LCP)への 無電解銅めっきプロセス

## トップLECSプロセス

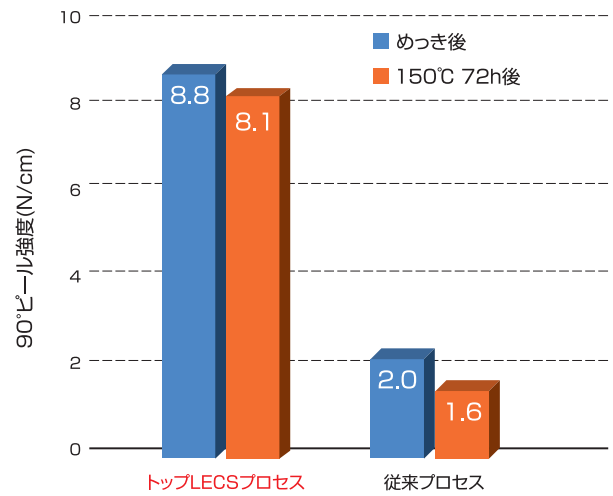
- 高周波高速伝送に適したLCPフィルムへめっきが可能
- 全湿式プロセスであり、直接無電解銅めっきが可能
- 表層を荒らすことなく高い密着性が得られる
- セミアディティブプロセスに対応し、ファインパターン性に優れる

### 全工程湿式プロセスによる直接無電解銅めっき



直接無電解銅めっきが可能

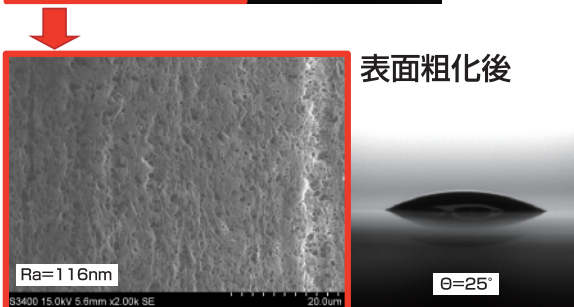
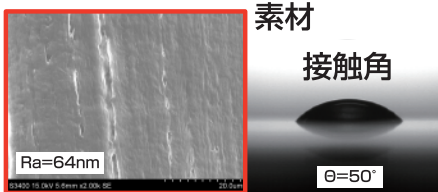
### 優れた密着性



ピール強度の比較(銅膜厚 18μm)

### 高速伝送に適した低粗化プロセス

#### トップLECSプロセス



### ファインパターン性に優れる

